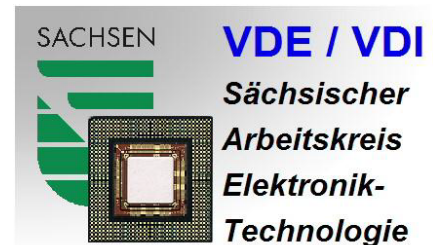


Obmann: Prof. Dr.-Ing. Reinhard Bauer
Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden
01069 Dresden
e-mail: bauer@htw-dresden.de

Koordinierung: Dr.-Ing. habil. Martin Oppermann, TU Dresden
e-mail: martin.oppermann@tu-dresden.de



68. Treffen des Sächsischen Arbeitskreises Elektronik-Technologie



Wissenschaftliches Kolloquium des IAVT & ZmP

Thema: **Wissenschaft und Praxis der Aufbau- und Verbindungstechnik**

Am **Freitag, dem 30. September 2016** an der **TU Dresden, Werner-Hartmann-Bau.**

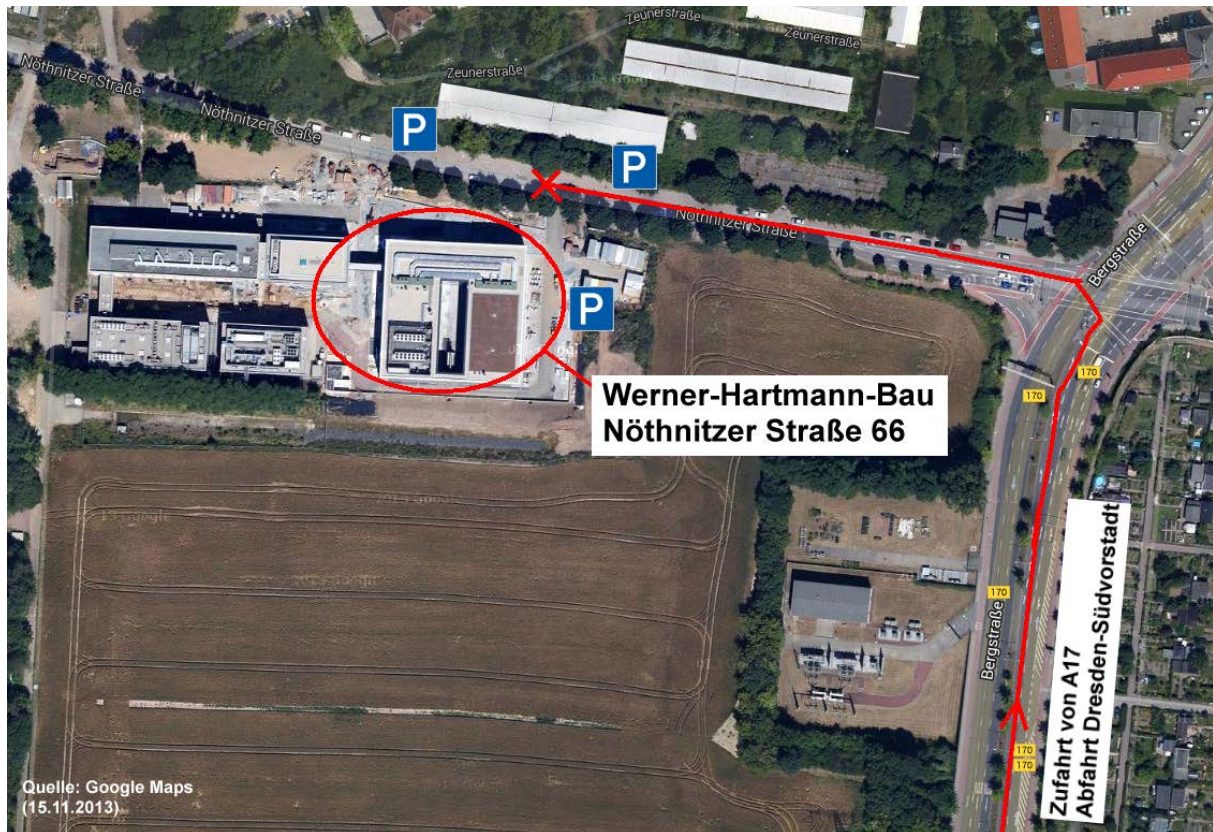
Programm:

- 09:00 Uhr Begrüßung und Einweisung
Herr Prof. Thomas Zerna, Herr Prof. Karlheinz Bock & Herr Prof. Reinhard Bauer
- 09:30 Uhr Rundgang und Vorführpraktika im Werner-Hartmann-Bau
Herr Prof. Zerna und Kollegen des IAVT/ZmP
- 12:00 Uhr *Mittagspause*
- 13:00 Uhr Additive Technologien – AVT der Zukunft?
Herr Prof. Karlheinz Bock, Direktor des IAVT
- 13:30 Uhr Smarte Systeme –
Vorstellung von Projektergebnissen aus HAEC, ATTO3D & OptaVer
Moderation: Herr Dr. Krzysztof Niewegłowski
- 14:00 Uhr *Kaffeepause*
- 14:30 Uhr Analytik-News -
IR-SimpleCam – Thermografie für die Leistungselektronik
Herr Dr. Michael Schaulin
- 15:00 Uhr Immer flexibel bleiben!
Die- & Drahtbonden auf Flex-Materialien – *Herr Dipl.-Ing. Daniel Ernst*
Anwendung polymerer Dickschichtpasten – *Herr Dr. Marco Luniak*
- ab 15:30 Uhr *Zentrales „Get together“ & Posterausstellung der Fakultät Elektrotechnik & Elektronik / Imbiss & Jazzkonzert in der Hochspannungshalle & Alten Mensa*

Da die Führungen und Praktika im Reinraum des Werner-Hartmann-Baus und das Catering genau organisiert werden müssen, bitten wir unbedingt um **rechtzeitige Anmeldung bis spätestens Mittwoch, den 21. September 2016** bei Herrn Dr. Oppermann (martin.oppermann@tu-dresden.de).

Veranstaltungsort / Adresse:

TU Dresden
Fakultät Elektrotechnik und Informationstechnik
IAVT & ZmP
Werner-Hartmann-Bau
Nöthnitzer Straße 66
01187 Dresden



Link zu IAVT & ZmP:
<https://www.avt.et.tu-dresden.de/>